

性能特点:

衰减范围:5dB到35dB 衰减精度:±0.2dB典型值

插入损耗: 3.9 dB 衰减附加相移: ±4° 输入输出:50Ω匹配

芯片尺寸:2mm×1mm×0.1mm

产品简介:

HH-DAT234 是一款三位宽带数控衰减器芯片,其频率范围覆盖 DC~18GHz,典型插入损耗 3.9dB,基本衰减位 5dB、10dB、 20dB, 衰减精度高, 附加相移小, 采用 0V/-5V 并行接口控制。

电参数:(T_A=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		GHz		
衰减范围	5		35	dB
插入损耗	2.7	3.9	5.1	dB
衰减精度	-	±0.2	-	dB
回波损耗 (直通)	-	16	-	dB
回波损耗 (衰减)	-	23	-	dB
输入功率 1dB 压缩点	-	23	-	dBm
衰减附加相移	-	±4	-	deg
切换时间	-	30	-	nS

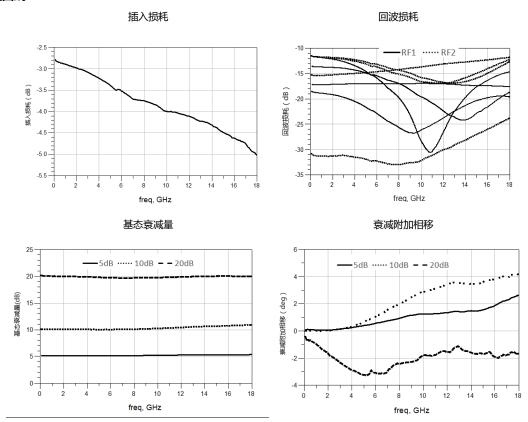
使用限制参数:

输入功率	+23dBm	
控制电压	0.5V/-7V	
存储温度	-65℃~150℃	
使用温度	-55℃~85℃	

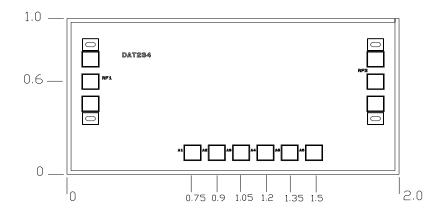
控制真值表:

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
基态	0	-5	0	-5	0	-5
5dB	-5	0	0	-5	0	-5
10dB	0	-5	-5	0	0	-5
20dB	0	-5	0	-5	-5	0

典型曲线:

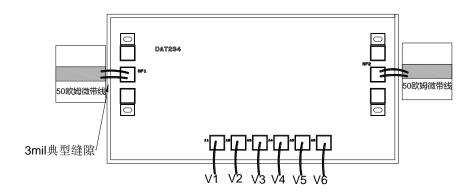


芯片尺寸图:(单位 mm)





芯片建议装配图:



使用说明:

存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作:输入输出各用 2 根 (建议直径 25um 金丝)键合线,键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

电话: 028-65796021 65796086